

证券代码：688041

证券简称：海光信息

投资者关系活动记录表

编号：2026-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位及人员	兴业证券、中信证券、国新投资、东吴证券、混沌投资、易方达基金、兴全基金、东方财富证券、南土资产、广发证券、华安基金、平安养老、财通基金
时间	2026年4月10日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书、副总经理、证券事务代表、董办投关人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2025 年全年及 2026 年一季度营业总收入、归母净利润分别实现多少同比增幅，核心增长驱动力是什么？</p> <p>答：2025 年全年营业总收入同比增幅 56.92%，归母净利润同比增幅 31.79%；2026 年一季度营业总收入同比增幅 68.06%，扣除股份支付影响的归母净利润同比增幅 74.86%。核心增长驱动力主要为 AI 算力需求爆发、数字基建升级带动 DCU 产品需求放量，同时随着国产化进程迈向商业化应用，公司 CPU 与 DCU 双产品线协同发力，推动业绩持续高增长。</p> <p>2、2025 年及 2026 年一季度研发投入分别为多少，研发投入占营业收入的比例如何，研发资金主要投向哪些领域？</p> <p>答：2025 年研发投入 45.69 亿元，2026 年一季度研发投入 12.11 亿元；其中 2026 年一季度研发投入占营业收入比例为 30.03%，维持</p>

高位水平。研发资金主要投向 CPU 与 DCU 产品迭代、AI 软件栈体系建设、HSL 协议应用推广及超节点技术布局等核心领域。

3、截至 2025 年末，DCU 产品已覆盖多少个行业、多少个应用场景，与主流大模型的适配情况如何？

答：截至 2025 年末，DCU 产品已覆盖 20 多个关键行业、300 余个应用场景；在大模型适配方面，已与 DeepSeek、Qwen3、ChatGPT、混元、智谱等 365 款主流大模型完成全面适配与联合精调，覆盖全球 99% 非闭源大模型，赋能从十亿级端侧推理到千亿级模型训练的全场景需求。

4、光合组织目前的合作伙伴数量、软硬件测试成果及联合解决方案数量分别是多少，生态建设对公司业务的支撑作用体现在哪里？

答：公司深入践行“芯片+生态”协同发展战略，通过“光合组织”汇聚了产业链上下游企业、高校、科研院所、行业用户等 6,000 余家合作伙伴，覆盖芯片设计、整机制造、AI 软件、行业应用等全产业链环节，在全国建立 34 个实体生态适配中心，4 个 OEM 联合实验室，41 个 ISV 联合实验室，基于海光“C86+DCU”计算平台，推动 1.5 万余项软硬件适配测试优化项目，基本形成从技术研发到市场拓展的完整生态体系；公司联合 10 余家国产 AI 芯片和硬件厂商，以及头部硬件基础设施厂商，共同启动生态共建计划，构建统一的互联标准，实现 AI 芯片与海光 CPU 的高效协同；公司还联合国内多家头部服务器厂商重磅成立了“生态联合实验室”，旨在围绕硬件设施、基础设施、人员投入、培训认证等多个环节进行深化布局，致力于构建协同、开放且可靠的生态平台。围绕 C86 技术路线，公司升级面向生态伙伴的“星海计划”，通过技术研发、适配调优、市场推广等全方位资源投入，全面支持上下游伙伴加速 C86 计算平台的开发与应用，携手核心软硬件生态伙伴逐步站稳关键行业，满足市场发展新要求、构筑发展新优势，共同推动海光整机生

态健康发展，共建开放包容、繁荣共生的信息技术生态系统，开辟兼顾效率、韧性和安全的中国计算市场。

5、公司在 CPU 互联总线协议（HSL）、超节点技术及 DCU 自研软件栈方面有哪些关键突破，后续技术迭代规划是什么？

答：关键突破包括：2025 年，公司 CPU 产品性能持续提升，开放 CPU 互联总线协议（HSL），在稳定性、能效比等核心指标上实现进一步突破，适配更多高端服务器场景，市场认可度持续提高。此外，近日国际权威标准组织 SPEC 公布了 SPEC Cloud IaaS 2018 最新测试成绩。浪潮云海 InCloud OS 通过搭载海光 C86 架构服务器，性能得分一举刷新国产厂商在该领域的实测纪录。

在 DCU 领域，公司“深算三号”成功投入市场，已进入行业、互联网等重要应用领域，持续 Day0 首发适配多家国内大模型产品，支持 AI 场景的多元化落地，成为 AI 算力竞赛的核心供应商。同时，前瞻布局超节点技术体系建设，在全对等互联、HSL 总线型协议等领域形成技术支撑。

后续迭代规划：加速 CPU 与 DCU 新品迭代，深化超节点技术布局，完善 AI 软件栈生态，提升产品性能与场景适配能力。

6、公司 2025 年度利润分配预案具体内容是什么，现金分红金额及比例如何？

答：2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记总股本扣除回购专用账户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计派现 3.48 亿元（含税）；叠加中期分红，2025 年度现金分红合计 5.57 亿元（含税）。

7、当前 AI 算力需求爆发、国产替代加速背景下，公司面临的核心行业机遇有哪些，如何把握这些机遇？

答：核心行业机遇包括三个方面：一是 AI 算力需求爆发，大模型、智算中心建设加速，带动 DCU 等智能计算产品需求持续释放；二是国产替代加速及商业领域落地双驱动，国家政策支持集成电路产业发展，高端芯片国产化率提升，同时公司产品在商业市场也得到了客户的广泛认可，形成了规模销售，为公司 CPU、DCU 产品拓展市场提供支撑；三是数字经济赋能，数字中国建设推进，政务、金融、能源等行业数字化转型，带动通用计算与智能计算需求双增。公司将持续加大研发投入，完善产品矩阵；深化生态合作，扩大市场覆盖；优化产能保障，提升交付能力；聚焦核心行业，深耕重点客户。

8、请问公司认为行业的壁垒核心在哪些方面，公司在研发投入，产品技术布局均居行业前列水平，面对国内外芯片行业的竞争格局，公司凭借“双芯战略”及开放生态形成了哪些差异化竞争力？

答：高端处理器行业的壁垒已从单一芯片设计演变为“技术+生态+系统”的三维综合门槛，具体体现在以下两个方面：

1. 高技术门槛。高端处理器研发涉及架构设计、电路实现、工艺制程、先进封装等多个高难度环节，对人才的创新能力和工程能力要求极高。随着大语言模型（LLM）及混合专家（MoE）架构的广泛应用，算力基础设施正从单芯片向“机架级”乃至“数据中心级”集成演进。以英伟达 GTC 2026 大会发布的 Vera Rubin 平台为例，其由 7 颗芯片和 5 类机架系统共同构成完整 AI 超级计算机，标志着“机架即计算机”成为行业新范式。这要求企业具备计算芯片、网络互联、整机设计、供电、内存、散热及系统软件的全栈协同能力，系统级门槛持续攀升。

2. 生态壁垒。生态是集成电路产业中最难逾越的软性门槛，本质是时间、规模和用户习惯长期积淀的结果。其核心在于指令集架构形成的“飞轮效应”：用户因丰富的应用选择硬件，开发者因庞大的用户基数开发应用，形成自我强化的闭环。此外，软件与操作系统

的适配、硬件协同与协议标准、市场信任等共同构成了完整的价值网络。这意味着，技术上的成功只是第一步，实现商业上的成功需要构建一个能吸引开发者、合作伙伴和用户的完整生态系统。

公司在面对技术演进和市场竞争时，基于双芯产品及开放生态，公司形成了以下四个维度的差异化竞争力：

1. 架构生态。海光 CPU 兼容 x86 指令集，拥有业界最成熟的生态支持，当前绝大多数服务器、硬件设备及软件系统均基于或兼容 x86。海光 DCU，兼容类 CUDA 架构，以良好的生态兼容性为用户提供强大的计算服务能力。

2. 技术布局。公司构建了“芯片+互联+整机+基础设施”的全栈布局。依托 CPU 与 DCU 的“双芯”协同，搭配自研 HSL 高速互联协议，深度整合产业链上下游企业的网络、系统等方面的技术，形成从 Scale-up 到 Scale-out 的完整计算平台闭环。

3. 产业生态。公司依托“光合组织”已凝聚超过 6,000 家生态合作伙伴。通过持续推进“星海计划”、“强芯固基计划”等专项，以开放姿态从核心部件、整机系统到应用软件全面打通生态链路，加速软硬件深度协同，全力投入产业生态共建。

4. 研发投入。公司研发团队实力雄厚，研发投入稳居国内行业前列。已在 HSL 协议、超节点技术等核心领域实现突破，并完成体系化的产品迭代，产品性能与能效比具备市场竞争力。

9、结合 2025 年及 2026 年一季度业绩表现，公司如何看待当前国内高端芯片行业的发展趋势，未来 3-5 年行业整体走向如何？

答：结合公司业绩及行业动态，当前国内高端芯片行业呈现“需求旺盛、国产替代加速、技术迭代提速”的核心趋势：一方面，AI 算力、数字基建等领域的需求持续爆发，带动通用计算与智能计算芯片需求双增长；另一方面，国家政策持续加码集成电路产业，高端芯片国产化率逐步提升，本土企业迎来发展机遇。未来 3-5 年，行业整体将向“技术高端化、产品集成化、生态协同化”方向发展，

	<p>AI 芯片、系统设计能力将成为竞争核心。</p> <p>10、公司研发人员规模、研发投入情况均明显高于行业其他厂商，公司在践行“双芯战略”过程中，如何平衡短期业绩增长与长期技术投入的关系？</p> <p>答：公司始终坚持“短期保增长、长期强壁垒”的发展思路，平衡短期业绩与长期研发投入：短期来看，依托 CPU、DCU 双产品线的市场需求放量，聚焦现有产品的产能交付与市场拓展，确保业绩持续高增长，为长期研发投入提供资金支撑；长期来看，持续将营收的较高比例投入核心技术研发，实现 AI 软件栈、超节点技术等领域突破，完善产品矩阵，强化技术壁垒，为未来业绩增长奠定基础。</p>
附件清单(如有)	
日期	